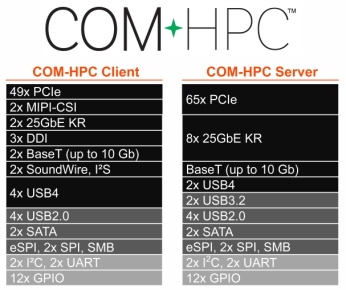
****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.com](http://www.congatec.com) | [info@sams-network.com](mailto:info@sams-network.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

**

***Das Pinout des neuen COM-HPC Standards***

*Text und Foto verfügbar:* [*https://www.congatec.com/de/congatec/pressemitteilungen.html*](https://www.congatec.com/de/congatec/pressemitteilungen.html)

Pressemitteilung

**PICMG Komitee für COM-HPC erreicht wichtigen Meilenstein**

**COM-HPC Pinout verabschiedet**

**Deggendorf, Germany, 13 November 2019 \* \* \*** congatec gibt bekannt, dass das technische Subkomitee der PICMG für COM-HPC das Pinout dieser neuen High-Performance Computer-on-Module Spezifikation verabschiedet hat. Der neue COM-HPC Standard befindet sich damit auf der Zielgeraden zu Ratifizierung der Spezifikationsversion 1.0, die im ersten Halbjahr 2020 veröffentlicht werden soll. Die in der COM-HPC-Arbeitsgruppe aktiven Computer-on-Modules Hersteller und Carrierboard Designer können nun erste Edge-Computing Designs auf Basis dieser vorab verabschiedeten Daten starten, die im nächsten Jahr voraussichtlich parallel mit den kommenden High-End Embedded Prozessorgenerationen von Intel und AMD auf den Markt kommen.

Jessica Isquith, Präsidentin der PICMG, ist erfreut über den Fortschritt der COM-HPC Spezifikation: „In der PICMG arbeiten wir derzeit an der nächsten Generation des für die Embedded- und Edge-Computing Welt wichtigsten COM Standard Formfaktors. Neben dem physischen Footprint ist das Pinout der essentiellste Meilenstein. Er konnte nur deshalb so schnell vorab verabschiedet werden, weil wir es geschafft haben, in der Arbeitsgruppe für COM-HPC alle wichtigen Player im Markt – inklusive der Halbleiterhersteller wie Intel – an einen Tisch bekommen zu bekommen. Dadurch konnte der COM-HPC Standard möglichst ideal für kommende Prozessorgenerationen ausgelegt werden.“

Christian Eder, Vorsitzender des Komitees, ist zuversichtlich, dass die Spezifikation noch vor der Verfügbarkeit der nächsten High-End Embedded Prozessoren offiziell verabschiedet werden kann: „Eine neue Computer-on-Modules Spezifikation ist eine komplexe Aufgabe, an der viele namhafte Unternehmen beteiligt sind. Wir haben aber bereits im Oktober 2018 offiziell unsere Arbeit aufgenommen und sind im Zeitplan, parallel mit den kommenden High-End Embedded Prozessorgenerationen neue COM-HPC Module, Carrierboards und Lösungsplattformen anbieten zu können. Sie werden die bestehenden PICMG COM Express Module-Standards um neue Lösungen erweitern, die in Richtung headless Edge-Server- und multifunktionalere Edge-Clients-Lösungen gehen.“

Mit der Verabschiedung des Pinouts haben nun alle Arbeitsgruppenteilnehmer eine solide Arbeitsgrundlage, Schnittstellen bis zu 100 GbE und PCIe der vierten und fünften Generation sowie bis zu acht DIMM-Sockel und High-Speed Prozessoren mit mehr als 200 Watt standardisiert auf COM-HPC Modulen anzubieten und an spezifikationskonformen Carrierboard-Designs zu arbeiten.

Zu den Mitgliedern der PICMG Arbeitsgruppe für COM-HPC zählen die Universität Bielefeld sowie die Unternehmen Adlink, Advantech, Amphenol, AMI, congatec, Elma Electronic, Emerson Machine Automation Solutions, ept, Fastwel, GE Automation, HEITEC, Intel, Kontron, MEN, MSC Technologies, N.A.T., Samtec, SECO, TE Connectivity, Trenz Electronic and VersaLogic. Die Unternehmen Adlink, congatec und Kontron treten zudem als Sponsoren des Komitees auf. Vorsitzender der COM-HPC Arbeitsgruppe ist Christian Eder, Marketing Direktor von congatec, der bereits als Draft Editor an der Weiterentwicklung des aktuellen COM Express Standards beteiligt war. Stefan Milnor von Kontron und Dylan Lang von Samtec unterstützen Christian Eder zudem in ihren Funktionen als Editor und Schriftführer der PICMG COM-HPC Arbeitsgruppe.

Weitere Informationen zum neuen COM-HPC Computer-on-Modules Standard und seinem Pinout finden Sie unter <https://www.congatec.com/COM-HPC>

**Über congatec**

congatec ist ein stark wachsendes Technologieunternehmen mit Fokus auf Embedded-Computing-Produkten. Die leistungsstarken Computermodule werden in einer Vielzahl von Systemanwendungen und Geräten in der industriellen Automatisierung, der Medizintechnik, dem Transportwesen, der Telekommunikation und vielen anderen Branchen eingesetzt. Im Segment Computer-on-Module ist congatec globaler Marktführer mit einer exzellenten Kundenbasis von Start-ups bis zu internationalen Blue-Chip-Unternehmen. Das 2004 gegründete Unternehmen mit Sitz in Deggendorf erwirtschaftete 2018 einen Umsatz in Höhe von 133 Mio. US Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de/) oder bei [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/455449), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*